

2018年5月16日
三菱電機株式会社

NEWS RELEASE

フレキシブル基板のさらなる高精度な微細加工と生産性の向上を実現
三菱電機基板穴あけ用 UV レーザー加工機「GTW5-UVF20 シリーズ」発売

三菱電機株式会社は、スマートフォンなどに使用されるフレキシブル基板※1に適した基板穴あけ用 UV レーザー加工機の新製品として、「GTW5-UVF20 シリーズ」を5月16日に発売します。新型ガルバノスキャナー※2や高速 UV レーザー発振器の搭載に加え、Synchrom (シンクローム) テクノロジー※3の採用により、さらなる高精度な微細加工と生産性の向上を実現します。

本製品は、「JPCA Show 2018 (第48回国際電子回路産業展)」(6月6日～8日、於：東京ビッグサイト)に出展します。

- ※1 薄く柔らかい絶縁体を使い、自在に曲げることができる構造のプリント基板
- ※2 ミラーを高速で駆動し、レーザー光を位置決めする装置
- ※3 加工テーブルの駆動・停止後にレーザー加工を実施していた従来の制御方式と異なり、加工テーブルの駆動とレーザー加工を同時に行うことで非加工時間を約50%短縮した制御方式



三菱電機基板穴あけ用 UV レーザー加工機「ML605GTW5-UVF20」

新製品の特長

1. **独自開発の新型ガルバノスキャナーを搭載し、さらなる高精度な微細加工を実現**
 - ・発熱による歪を抑制することで、ガルバノスキャナーの位置決め精度を従来比15%向上※4
 - ・小径加工に対応した光路設計の採用により、最小穴径を従来比25%微細化※4
 - ※4 従来機 GTW4-UVF20 シリーズとの比較 (加工内容、加工材料などによって異なります)
2. **独自の制御技術と2ワーク同時加工により、生産性を向上**
 - ・新型ガルバノスキャナーと高速 UV レーザー発振器の搭載に加え、Synchrom テクノロジーの採用により、生産性を従来比約10%向上※4
 - ・2つの加工ヘッドを搭載し、2ワーク (加工対象) を同時に高速加工

発売の概要

製品名	形名	発売日	目標販売台数
基板穴あけ用 UVレーザー加工機 GTW5-UVF20 シリーズ	ML605GTW5-UVF20	5月16日	年間100台

報道関係からの
お問い合わせ先

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 TEL 03-3218-2359 FAX 03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部

発売の狙い

スマートフォンやタブレットPCなどの電子機器のさらなる小型化・高機能化に対応するため、フレキシブル基板の需要が拡大している中、UVレーザー加工機によるさらなる高精度な微細加工と生産性の向上が求められています。

当社は今回、これらのニーズに応えるため、新型ガルバノスキャナーや高速 UV レーザー発振器の搭載に加え、Synchrom テクノロジーを採用した基板穴あけ用 UV レーザー加工機「GTW5-UVF20 シリーズ」を発売します。

主な仕様

項目		仕様
システム	形名	ML605GTW5-UVF20
	外形寸法 (mm) ^{※5}	4100W×3370D×2270H
	機器質量 (kg) ^{※5}	7500
加工機	XY テーブル	加工ワーク寸法 (mm) 620×560
発振器	レーザーの種類 UV レーザー	
	出力 (W) 20	

※5 加工機・発振器・制御装置・冷却装置・ワーク吸着装置・電源盤を含めた寸法・質量
基板搬送装置（オプション）の仕様によって寸法・質量は異なります

環境への貢献

製造現場における生産性の向上により、消費電力の削減に貢献します。

製品担当

三菱電機株式会社 名古屋製作所
〒461-8670 愛知県名古屋市東区矢田南五丁目 1 番 14 号
TEL 052-712-2209 FAX 052-712-3483

お客様からのお問い合わせ先

三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
TEL 03-3218-6540 FAX 03-3218-6822